

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-04

投资者关系活动类别	■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名	长信基金、华泰保险、中庚基金、诺安基金、国金基金
时间	2026 年 7 月 29 日 10:30-11:30
地点	上海市浦东新区申江路 5005 弄 3 号楼 10 层
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：杨彪
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2025 年度及 2026 年第一季度业绩情况 2025 年度，公司实现营业收入 15.70 亿元，较上年同比增加 4.40%；本年度实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润实现 0.36 亿元，较去年同比增加 0.69 亿；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 0.18 亿元，较去年增加 0.27 亿。 公司不断优化产品结构，使得电机控制驱动芯片业务收入实现同比上升 25.95%，收入占比同比提升 4.36 个百分点；同时，依托于 DrMOS 产品适应市场需求革新突破，高性能计算电源芯片业务收入实现同比上升 122.26%，收入占比同比上升 3.24 个百分点，增长显著。另外，报告期内公司持续推进工艺及封装技术迭代，有效实现成本控制，带动收入毛利实现双升。 2026 年第一季度，公司实现营业收入 6.09 亿元，较上年同比上升 86.35%；实现归属于上市公司股东的净利润

	0.37 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.32 亿元，自 2025 年第二季度起实现四个季度连续盈利。 二、问答环节 1、公司并购易冲目前的整合成效如何？对业绩有什么影响？ 答：今年 3 月公司完成了对易冲的并购。交易完成后，公司围绕平台化战略定位，整合四川易冲在无线充电、通用充电管理芯片、汽车电源管理芯片、协议芯片等细分市场的优势产品与技术积累，进一步拓展在消费电子及汽车等重点终端市场布局，构建产品矩阵互补、市场渠道协同、研发资源融合业务体系。在产品方面补齐了公司在智能手机、可穿戴设备等消费电子终端的芯片布局；在市场方面与易冲建立业务协同机制，实现销售资源共享、FAE 互通与联合市场推广，通过提供矩阵型产品解决方案等方式切入关键客户；在研发方面，双方在电路与系统设计上将通过研发经验、研发资源、研发 IP 共享等提升整体研发效率。 今年一季度公司原营业收入 5.02 亿，将四川易冲 3 月财务数据纳入合并范围，合并其 3 月营业收入 1.07 亿元，公司综合实现营业收入 6.09 亿元，同比增幅达 86.35%，影响显著；报告期内公司原业务毛利率 41.06%，四川易冲 3 月账面价值毛利率 35.40%，公司综合毛利率实现 40.06%。考虑并购产生的资产评估增值影响后，四川易冲 3 月公允价值毛利率 20.29%，公司综合毛利率 37.41%。 剔除并购易冲影响后公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,427.63 万元。易冲 3 月账面净利润 1,070.80 万元，考虑并购产生的资产评估增值影响后，公允价值分摊后易冲净利润为-751.70 万元，公司综合实现归属于上
--	---

	市公司股东的净利润 3,675.93 万元。 2、公司实施了较高比例的现金分红后，流动性和资金状况有受到影响吗？ 答：公司 2025 年度现金分红政策是综合考量了行业发展趋势、公司规模与发展潜力、相关政策等多重因素，并结合公司货币资金及资金支出计划等情况后审慎做出的决策，符合公司实际情况，没有导致公司出现流动性风险，也没有对公司偿债能力和日常经营产生不利影响。公司具备稳定、可持续的内生现金创造能力，未来公司依靠主营业务持续回笼经营款项，足以应对日常运营支出和短期到期债务偿付。 3、去年经营活动产生的现金流量净额下降的原因是什么？ 答：2025 年营业收入上升同步带动供应商采购需求增加，购买商品、接受劳务支付的支出相应上升；同时人员规模扩大，相应支付给职工及为职工支付的现金增加。 4、公司如何稳住毛利率水平？ 答：一方面通过持续的工艺迭代与供应链整合，单位成本在整体产品单位价格上升的同时维持了稳定；同时产品结构不断优化，高毛利率产品收入占比持续提升，推动综合毛利率稳中有升。 5、公司各产品线经营情况如何？ 答：①LED 照明驱动芯片业务： 2025 年，公司积极扩大智能 LED 照明产品的市场布局，目前在可控硅调光业务及高性能灯具电源业务上保持领先地位，同时实现北美 0-10V 调光大功率照明产品、DALI 调光业务的显著增长，另外第六代高压 BCD-700V 工艺平台及独占创新封装 EHSOP12 逐步量产，并通过供应链整合，毛利率提升 2.43 个百分点。
--	---

	②AC/DC 电源芯片业务： AC/DC 电源芯片业务在报告期内实现稳步增长，大家电电源业务成为格力、美的、TCL 等国内头部家电品牌及其板卡厂的电源供应商；小家电电源业务在“无 VCC 电容”专利加持下，延续 2024 年的快速发展态势，保持高速增长，在国内小家电头部品牌例如九阳、小米、徕芬、美的等份额进一步提升；快充业务方面，零待机方案已经在国际一线品牌量产并规模出货。另外随着新产品的陆续推出，在品牌手机中的业务份额得到进一步提升。 ③电机控制驱动芯片业务： 公司通过技术创新持续提升产品集成度和性能，推动业务高速发展。报告期内，汽车电子业务继续实现突破，推出了超高集成度的 ALL-in-One 智能车规级 MCU，空调出风口产品销量超百万颗，热管理及座椅通风均有产品进入量产。 ④高性能计算电源芯片业务： 产品线下的数字多相控制器、DrMOS、POL 及 Efuse 全系列产品已经实现量产，进入规模销售阶段，特别是新一代显卡应用，多家海外和国内客户开始大批量出货，带动高性能计算电源芯片业务增长，当期实现销售收入 0.96 亿元，同比上升 122.26%，更多国际、国内客户实现业务破局。公司通过持续的 BCD 工艺和产品创新，第二代 DrMOS 芯片性能显著提升，成本明显下降，市场竞争力增强，已获得多家客户导入，进入量产阶段。 6、公司的研发人员、费用和研发成果情况如何？ 答：截至 2025 年末，公司共有研发人员 467 人，占公司员工总人数的 67.98%，人员规模较去年基本持平。研发费用方面，2025 年公司累计投入近 3.86 亿元，占营业收入比例为 24.58%。
--	--

	目前，公司已完成了对高压 BCD-700V 工艺平台的技术升级，第六代高压工艺平台开始量产，可覆盖 LED 照明驱动芯片、AC/DC 电源芯片和部分电机控制驱动芯片产品，进一步巩固了公司在高压工艺技术和产品的领先优势。 低压 BCD 工艺平台方面，公司自研的第一代 40V BCD 工艺平台高性能计算电源芯片已大批量稳定量产，基于自研第二代 40V BCD 工艺平台设计的 DrMOS 产品，已经开始批量生产，性价比显著提升。目前公司正在推进第三代 40V BCD 工艺的研发，基于该工艺平台的芯片设计已经完成，等待生产验证，预计将在 2026 年实现量产。 封装技术方面，公司独占封装 EHSOP12 已进入量产阶段，EMSOP 封装技术也在持续导入量产中，预计将进一步带动成本下降。
附件清单（如有）	/
日期	2026 年 7 月 29 日